Procedura Laser & Taglio circuiti:

Laser:

1. Collegare macchina tramite wifi a workspace (altrimenti campo “spessore materiale” non compare NELLA NUOVA VERSIONE NON COMPARE “MATERIAL THICKNESS”)
2. Eseguire procedura di focus laser inserendo nella tasca il materiale da incidere per la calibrazione. ATTENZIONE: spessore materiale deve essere quello di dima+parte che sporge del maeriale da incidere (di solito intorno a 19.8-20.2 mm) -ADESSO LA SCHEDA NON SPORGE DALLA DIMA

Meglio non usare procedura automatica ma fissare il laser height in settings

1. Usare parametri in macro “Origine dima Laser” per settare work origin

Se non cè il macro, crearlo inserendo questa istruzione: G92 X... Y...

1. Mettere in spessore materilale quello totale (dima+spessore piastra che sporge)
2. Lanciare laser

CNC:

1. Montare testina di taglio
2. Settare origine di X e Y (usando i comandi dentro macro “Origin Dima CNC”)

Se non cè il macro, crearlo inserendo questa istruzione: G92 X... Y...

1. Settare Z in modo tale che punta tocchi fondo tasca dima
2. Posizionare piastra dentro dima
3. Lanciare il taglio